



教育部  
資通訊軟體創新人才推升計畫

## 「學生實習媒合平臺」

### 使用邀請函

敬啟者：

為培育國內社會及產業發展所需之資訊軟體人才，教育部於民國 99 年起推動「資訊軟體人才培育」，為配合此中綱計畫執行，本年度規劃並推動資訊科技人才實習與就業媒合業務，建立一人才媒合服務平臺提供企業徵才，本計畫每年增加約 3000 位資通訊相關科系學生透過此平臺找尋實習與就業機會。企業可免費使用此平臺刊登職缺、利用人才搜尋功能找尋合適的實習生/工作人選。誠摯邀請貴系學生一同使用此媒合平臺，提供學生實習機會，提升產學連結。得荷支持，不勝感激。此

順 頌

研 安

教育部資通訊軟體創新人才推升計畫

學生實習媒合平臺推廣團隊 敬邀

媒合平臺登入首頁：<https://job.itsa.org.tw>

聯絡信箱：[contact@itsa.org.tw](mailto:contact@itsa.org.tw)